

ノーシアン高速無電解銅めっき液

Cyanide-free, High-speed Electroless Copper Plating Solution

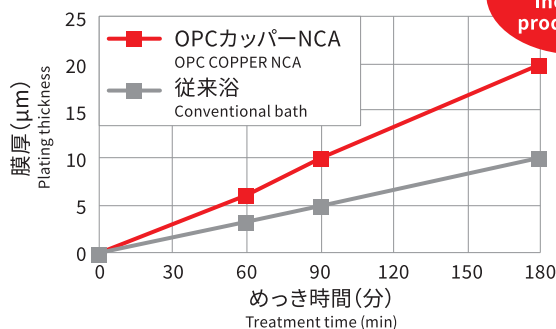
OPCカッパーNCA

OPC COPPER NCA

- 高い析出速度
Great deposition performance
- 浴中のホルムアルデヒド濃度を低減
Decrease formaldehyde concentration in bath
- ファインパターン性に優れる
Excellent in fine pattern ability
- 浴安定性に優れる
Excellent bath stability

高い析出速度 6 μ m/h

Great deposition performance 6 μ m/h



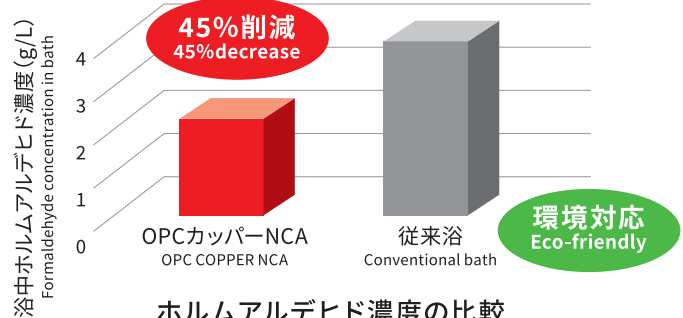
めっき時間と膜厚の関係

Relationship of treatment time and plating thickness

生産性向上
Increase productivity

低いホルムアルデヒド濃度

Low formaldehyde concentration



ホルムアルデヒド濃度の比較

Comparison of formaldehyde concentration

45%削減
45% decrease

環境対応
Eco-friendly

無電解めっき用シード層ペースト

Paste to Form Seed Layer for Electroless Plating

トップALP CP-1958

TOP ALP CP-1958

- 印刷パターン性に優れる
Can be printed easily and finely
- 基板およびめっき皮膜との密着性に優れる
Great adhesion performance between substrate and plated film

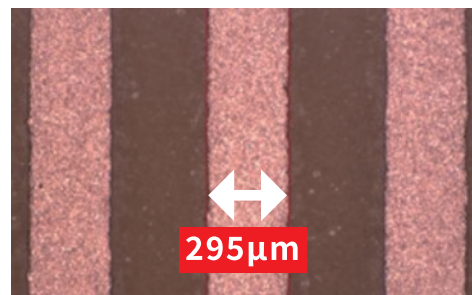
ペースト特性

Past specification

概要 Outline	銅粉含有熱硬化型ペースト Thermosetting paste containing copper powder
銅粉粒子径 Copper powder particle size	3 μ m
硬化温度 Thermosetting temperature	160 $^{\circ}$ C, 60分 min
電気伝導性 Electric conductivity	なし No
めっき密着性(クロスカット法) Tape peel test	剥離なし No peel

ファインパターン性に優れる

Excellent in fine pattern ability



無電解銅めっき後のパターン

After electroless copper plating

L/S=300 μ m/300 μ m